

苏州固锴电子股份有限公司

鉴证报告

截至2016年6月30日止

关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目 前次募集资金使用情况

信会师报字[2016]第115743号

苏州固锴电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”）董事会编制的截至2016年6月30日止的《关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏州固锴向其董事会、深圳证券交易所呈报募集资金使用情况相关资料时使用，不得用作任何其他目的。出具本报告的会计师事务所和签字会计师不承担因本报告不恰当使用所造成的法律责任或其他责任。

二、董事会的责任

苏州固锴董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2016年6月30日止的《关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州固锴董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，苏州固锔董事会编制的截至2016年6月30日止的《关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了苏州固锔截至2016年6月30日止的基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨力生

中国注册会计师：郑贤杰

中国·上海

二〇一六年八月十七日

苏州固锴电子股份有限公司 截至2016年6月30日止的 关于基于QFN技术的系统级封装 (SiP) 项目 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,苏州固锴电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“苏州固锴”)本公司将截至2016年6月30日止的基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锴电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,苏州固锴电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“苏州固锴”)非公开发行人民币普通股3,960万股,每股面值1元,每股发行价13.08元,募集资金总额517,968,000.00元,根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元,实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止,本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

二、 基于QFN技术的系统级封装 (SiP) 项目基本情况

根据 2011 年 5 月 5 日,由苏州市经济和信息化委员会发布的《关于同意苏州固锴电子股份有限公司基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目核准的批复》(苏经信产投【2011】13 号)同意苏州固锴实施基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 建设项目。根据公司第三届董事会第十六次会议以及 2010 年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次非公开发行募集资金将投资于基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个项目,其中,基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目计划投资情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	建设期	拟投资总额	募集资金计划投资额
基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目	1 年	20,730.61	18,657.55

本项目计划建设具有先进工艺水平的基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）生产线，将利用现有厂房和部分设备，从国外新引进印刷机、贴片机、回流炉、晶圆焊接机等关键生产设备 127 台(套)，从国内新购置激光刻字机、氮气烘箱等生产设备 44 台(套)。根据 2011 年 11 月 23 日本公司公告的《2011 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》承诺，项目达到设计产能后，将可形成年产 QFN-SiP 封装器件 1.8 亿只的产能。

根据 2013 年 4 月 19 日本公司公告的《苏州固锴电子股份有限公司关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的公告》，基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，主要原因为客户认证周期加长。

根据 2016 年 3 月 31 日本公司公告的《苏州固锴电子股份有限公司关于调整募集资金项目投资进度的公告》，基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目达到预定可使用状态日期由 2015 年 12 月 31 日调整为 2016 年 6 月 30 日，主要原因为本项目产品自推向市场以来，逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低，也受益于智能手机、智能手环等穿戴类产品市场对 SiP 产品的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目前已通过多家客户认证，产品订单逐渐增加。截止 2015 年末，本项目产能已达到 12KK/月，此后公司陆续增加设备等生产资源的投入，预计在 2016 年 6 月底可达到本项目产品预计产能 15KK/月，完成本项目的建设投资。

三、 基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目前次募集资金的实际使用情况

（一） 截至 2016 年 6 月 30 日止，基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目前次募集资金的实际使用情况对照：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目名称：		基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目					
投资项目募集资金总额：		18,657.55	投资项目已累计使用募集资金总额：		8,927.41		
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：				8,927.41	
变更用途的募集资金总额比例：		2011 年：				1,932.13	
		2012 年：				840.83	
		2013 年：				1,366.88	
		2014 年：				1,255.65	
		2015 年：				1,564.67	
		2016 年 1 至 6 月：				1,967.25	
截止日募集资金投资项目产能完成情况				截止日募集资金累计投资额			
承诺年产能	是否达到承诺产能	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	承诺投资金额 (1)	实际投资金额 (2)	已签订合同尚未支付金额 (3)	累计投资额 (4) = (2) + (3)	累计投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 (5) = (1) - (4)
1.8 亿只	是	2016 年 6 月 30 日	18,657.55	8,927.41	776.57	9,703.98	8,953.57

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目的情况未发生变更。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目不存在对外转让或置换情况。

（四） 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目的实际投资总额为人民币 8,927.41 万元，已签订合同尚未支付金额为人民币 776.57 万元，募集后承诺投资总额为人民币 18,657.55 万元，累计投资额少于承诺的差额为人民币 8,953.57 万元。该项目节约金额占承诺投资金额的 47.99%，募集资金未使用完毕的原因如下：

1. 设备升级换代带来的设备效率大幅提升，性能价格比有很大差异，如晶片焊接机原来测算需要 22 台，项目立项时的单台设备 UPH 还在 3000pcs/H,预算采购金额为 15 万美金，新一代的单台设备 UPH>10000,设备采购金额大约 20 万美金，实际采购 12 台就已经满足项目要求。
2. 在本行业设备采购成本比较低的时期与供应商达成多套设备采购的协议，以降低采购成本。在 2014，2015 年期间，半导体行业由于扩张过快，市场需求降低，很多设备供过于求，在这个期间就能用较低的价格集中采购设备。
3. 产品设计上的提升，原来的引线框/基板设计没有采用高密度设计，以 2X2mm 的产品为例，原来的引线框/基板设计一条只能放置 1600 颗，新的设计一条能放 2160 颗，生产效率提升了 35%，相应的设备采购也就减少了 35%。
4. 从市场需求预期出发，避免短期内采购过多设备造成产能过剩。

苏州固锴电子股份有限公司

董事会

2016年8月17日